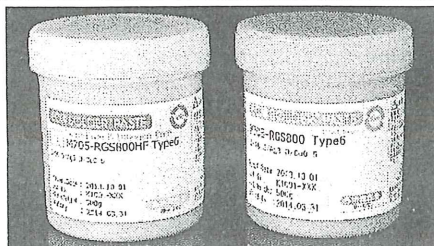


属業 0201チップ部品用 住金 千工 はんだペーストを2種

千住金属工業は、0201チップ部品(0.2×0.1mm)実装用のはんだペースト「M705」RG8800 Type6とハロゲンフリー仕様「M705 RGS800HF」部品で、一部の部品メーカー

1から来春の市場投入が発表されている。

M705 RGS800 Type6は、はんだ粉末として従来一般的に使用されている30μmではなく、10μmの極微細粉を使用した。はんだペーストの粘弾性の最適化を行うことで、0201チップ部品実装を想定した40μmマスク厚、開口径100μmの開



口寸法においても、ばらつきが少ないのはんだ供給を可能にした。また、はんだペーストははんだ粉末微細化に伴い粉末表面積が増加し、表面酸

0201チップ部品実装用はんだペースト

化被膜増加の影響からのはんだ付け性が劣化することが知られている。M705 RGS800 Type6は、超微粉用フラックスの開発で、この問題に対処し安定したはんだ接合を可能とした。

はんだ合金は、鉛フリー業界標準のM705(3/0%銀-0/5%銅)スズを使用。0201チップ部品のほか、0.2mmピッチフリップチップなどの実装にも対応。モジュール基板製造ユーザーなどに

サンプルを提供しており、年内の量産開始を予定している。